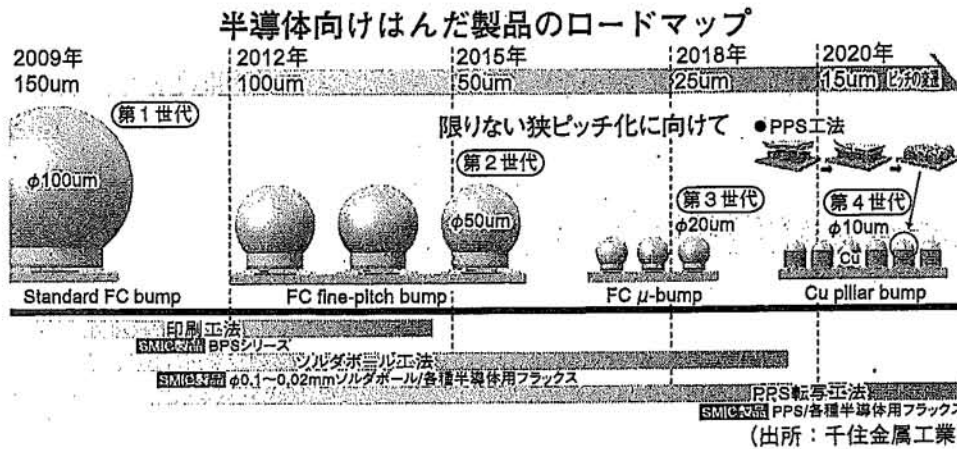


千住金属工業が新製品開発に注力 限りない狭ピッチ化に対応 半導体関連のはんだ充実

千住金属工業は、限りない狭ピッチ化の実現に向けて、半導体関連のはんだ製品を充実している。
半導体パッケージ向けの「エコソルダボール M7 70」は、全く新しい発想の「転写用はんだシートP



PS工法」、3次元接続のめつきを施した「銅核ボール」など、特徴ある製品をそろえている。
「DELTA LUX901 K5」、銅ボールにはんだ半導体パッケージの3次元化、軽薄短小化と低価格化がさらに進む中で、バンパ形成には超微細・高精度・高真球度・狭公差を兼ね備えたはんだボール要求に応じ、25 μ mピッチ実装を実現する。同社独自のシラスポラスガラスを塗布したフィルム表面を利用した膜乳法で製造した狭乳法で、粒度分布&真球微小はんだ公差高真球度粉末を高密度に1層付着させた転写用のはんだシートを製造している。

「DELTA LUX901 K5」、銅ボールにはんだ半導体パッケージの3次元化、軽薄短小化と低価格化がさらに進む中で、バンパ形成には超微細・高精度・高真球度・狭公差を兼ね備えたはんだボール要求に応じ、25 μ mピッチ実装を実現する。同社独自のシラスポラスガラスを塗布したフィルム表面を利用した膜乳法で製造した狭乳法で、粒度分布&真球微小はんだ公差高真球度粉末を高密度に1層付着させた転写用のはんだシートを製造している。

「エコソルダボール M7 70」は、モバイル機器用と耐熱疲労特性を両立した高い接続信頼性を提供する。現在、微小ボールの主役は ϕ 50 μ mだが、さらに狭ピッチ化の要求に対応し、この技術を応用した ϕ 20 μ mボールの実用化を目指している。

銅ボールに、はんだめつきやNi(ニッケル)めつきを施した銅核ボールを開発した。銅核ボールは、ソルダボールの技術を生かして、3次元実装向けに開発した。部品内蔵3次元実装における半導体や、部品を内蔵する精度の高い空間確保を可能にする。80 μ mから各種をそろえている。

超低残渣フラックスのDELTA LUX901 K5は、3次元接続のバンパ接続用。洗浄を行わずにアンダーファイルを注入できる。パワー半導体用として、ダイを水平に保ち、はんだ厚や傾斜に起因するはんだクラックを抑制し、高放熱特性を実現させるNiボール入りプリフォームHQもある。